

SK하이닉스

AI 메모리 슈퍼사이클의 승자 — HBM 1위가 만든 사상 최대 실적

기준일 2026-06-15 · FY2025 실적 + 2026 Q1 · 분석 보고서

97.1조

FY2025 매출

47.2조

FY2025 영업이익

72%

2026 Q1 영업이익률

~1,000조

시가총액 (₩)

HBM 리더십이 사상 최대 실적·시총 1,000조를 만들었다

01

FY2025 사상 최대 — 매출 97.1조·영업이익 47.2조

47.2조

영업이익 2배(+101%)·이익률 49%로 삼성전자를 넘어섰다. HBM 매출 2배.

02

2026 Q1 영업이익 37.6조·이익률 72% — 가속

72%

분기 매출 첫 50조 돌파. AI 메모리 슈퍼사이클이 본격화.

03

HBM 1위·시총 \$1T — 단, 사이클·경쟁이 관건

\$1T

엔비디아 HBM4 다수 공급. 삼성·마이크론 추격과 메모리 사이클이 점검 포인트.

글로벌 메모리 Big 3 — DRAM·NAND·HBM의 강자

1983

설립 (현대전자)

곽노정

대표이사 사장

이천

본사

46,863

임직원 (2024)

사업·포지션

- DRAM — 글로벌 2위, 점유율 약 30%
- NAND — 점유율 약 20%
- HBM — 글로벌 1위 (AI 메모리)
- 2012년 SK그룹 편입
- Big 3: 삼성·SK하이닉스·마이크론

HBM이 이익을 견인하고 DRAM·NAND가 토대를 이룬다

HBM

AI 메모리 (1위)

엔비디아 가속기향 고대역폭 메모리. 2025 매출 2배 — 이익의 핵심 동력.

DRAM

범용·서버 (점유율 30%)

1cnm 공정·DDR5·서버 D램. HBM의 기반 기술.

NAND

낸드 플래시 (점유율 20%)

321단 QLC. 데이터센터 SSD 수요 대응, 하반기 회복.

AI 가속기 수요가 HBM·고부가 메모리를 끌어올리고, 그 위에 범용 DRAM·NAND 사이클이 더해지는 구조다.

모든 지표가 사상 최대 — 메모리 역사상 최고의 해

97.1조

FY2025 매출 (+47%)

47.2조

영업이익 (+101%)

49%

영업이익률

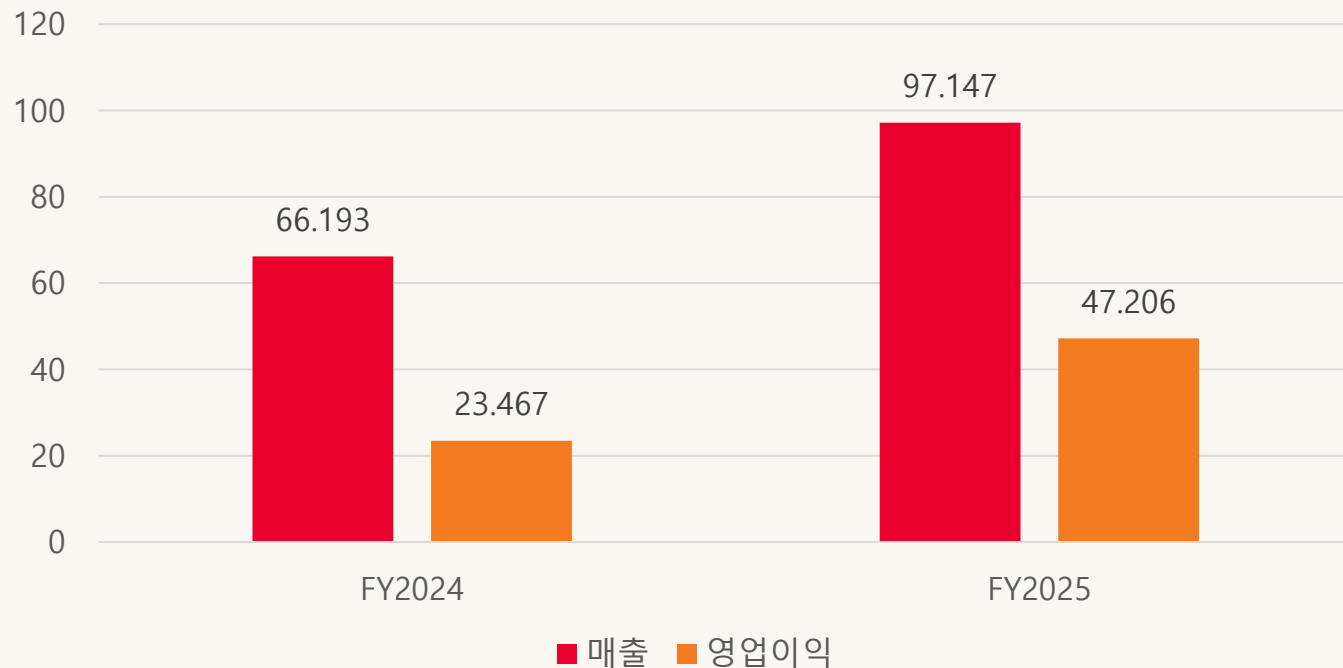
42.9조

순이익

영업이익 47.2조는 전년의 2배로, 같은 해 삼성전자 영업이익을 넘어섰다. HBM 매출이 두 배로 뛰며 AI 메모리 중심 수요 구조가 실적을 견인했다.

매출은 +47%, 영업이익은 2배 — 1년 만의 도약

연간 매출·영업이익 (조원)



+47%

매출 YoY

+101%

영업이익 YoY

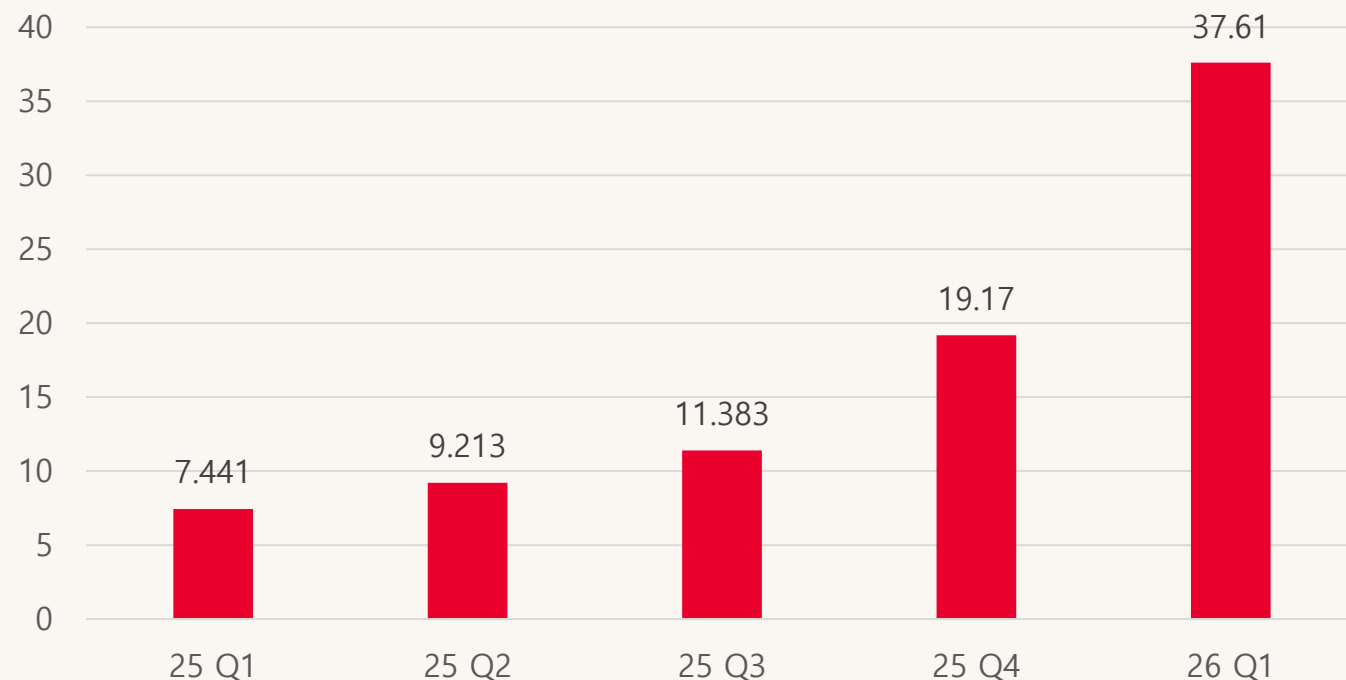
49%

FY2025 영업이익률

* K-IFRS 연결. 2026-01-28 발표.

분기 영업이익이 5분기 만에 5배 — 7.4조에서 37.6조로

분기 영업이익 (조원)



52.6조

2026 Q1 매출 (첫 50조)

72%

2026 Q1 영업이익률

+198%

2026 Q1 매출 YoY

* 2025 Q3 분기 영업이익 첫 10조 돌파. 2026 Q1 사상 최대.

영업이익률이 35% → 72%로 — 메모리 회사의 이례적 수익성

35%

FY2024 영업이익률

49%

FY2025 영업이익률

58%

2025 Q4

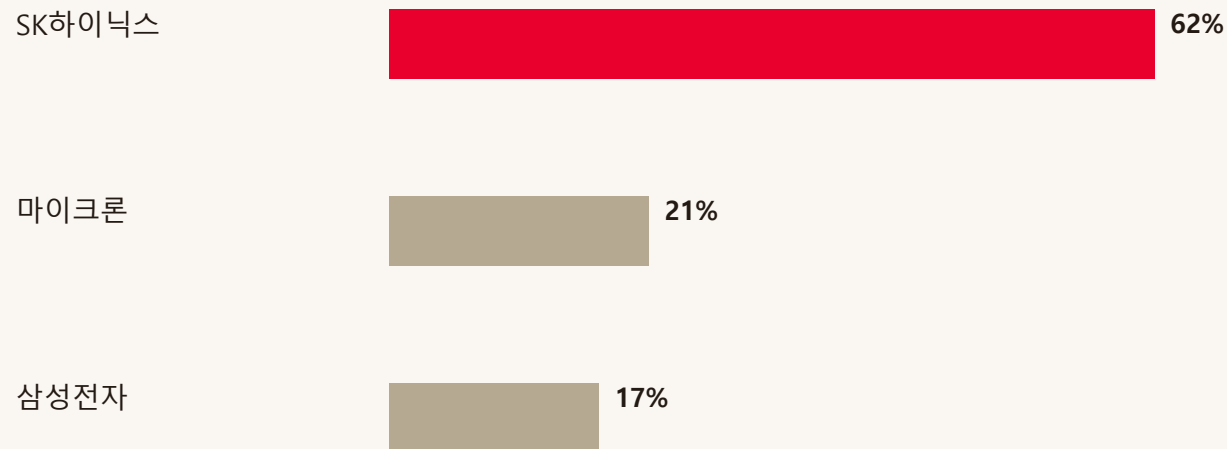
72%

2026 Q1 (사상 최대)

HBM·고부가 D램 가격 강세로 매출 1원당 이익이 급격히 커졌다. 2026 Q1 영업이익률 72%는 메모리 산업에서 유례를 찾기 어려운 수준으로, 슈퍼사이클의 강도를 보여준다.

HBM 시장은 SK하이닉스가 1위 — AI 메모리의 표준

HBM 시장 점유율 (추정, %)



최초

HBM3E 양산

최초

HBM4 양산능력

2배+

2025 HBM 매출 성장

HBM3E를 가장 먼저 양산해 엔비디아 공급의 다수를 확보했고, HBM4도 업계 최초로 양산능력을 갖췄다.

* 점유율은 증권가/리서치 추정(Astute 등) — 출처별 편차.

차세대 HBM4에서도 엔비디아 수요의 다수를 노린다

최초 양산

HBM4 선점

업계 최초 HBM4 양산능력. 엔비디아 차세대 (Rubin) 가속기향 공급.

54~70%

엔비디아 HBM4 점유 전망

Counterpoint 54% ~ UBS 70% 등 추정 — 선두 유지 기대.

2/3

2026 HBM3E 비중

2026 HBM 출하의 약 2/3가 HBM3E, HBM4 점진 확대.

* 엔비디아 HBM4 점유율은 증권가 추정으로 편차가 크다(54~80%). HBM4 양산 수율·고객 확보가 실질 변수다.

DRAM — 점유율 30%의 토대 위에 1cnm로 전환한다

30%

글로벌 DRAM 점유율

삼성에 이은 2위. 서버·범용 D램의 안정적 기반.

1cnm

6세대 10nm 개발 완료

차세대 미세공정으로 원가·성능 경쟁력 강화.

DDR5

256GB RDIMM

고용량 서버 모듈 — 데이터센터·AI 수요 대응.

DRAM은 HBM의 기반 기술이자 현금흐름의 토대다. 미세공정 전환이 HBM 경쟁력으로 이어진다.

NAND — 321단 QLC로 데이터센터 저장 수요를 겨냥한다

20%

글로벌 NAND 점유율

메모리 포트폴리오의 한 축. AI 데이터센터 SSD 수요.

321단

QLC 개발 완료

고적층 기술로 용량·원가 개선.

회복

하반기 반등

상반기 약세에서 연간 사상 최대 매출로 전환.

NAND는 사이클 변동이 크지만, AI 데이터센터의 대용량 저장 수요가 구조적 회복을 뒷받침한다.

AI 가속기 수요가 만든 메모리 슈퍼사이클의 한가운데

2배+

2025 HBM 매출 성장

72%

2026 Q1 영업이익률

\$1T

시가총액 (세계 16위)

AI 학습·추론용 가속기에 HBM이 필수로 탑재되며 고부가 메모리 수요가 폭증했다. 공급이 빠듯한 가운데 가격이 강세를 보여, 메모리 기업의 이익이 구조적으로 확대되는 국면이다.

HBM4·1cnm·321단 — 전 제품군에서 선단 공정을 선점한다

HBM4

업계 최초 양산능력, 엔비디아 차세대 가속기향

DRAM

1cnm(6세대 10nm) 공정 개발 완료, 256GB DDR5 RDIMM

NAND

321단 QLC 개발 완료

AI 메모리 확장

SOCAMM2, GDDR7

용인 클러스터·패키징 투자로 공급 능력을 확장한다

M15X

청주 팹

생산능력 극대화 — HBM·D램 캐파 확대.

용인

반도체 클러스터

1기 팹 건설 — 차세대 생산 거점.

패키징

청주 + 美 인디애나

어드밴스드 패키징 — HBM 핵심 후공정.

HBM은 후공정(패키징) 비중이 커, 패키징 캐파가 곧 HBM 공급 능력이다. 대규모 capex는 기회이자 회수 부담이다.

주가가 사상 최고 — 1년 새 시총 1,000조를 돌파했다

160만원 +

사상 최고가 (2026-05)

1,000조

시가총액 (₩)

\$1.0T

달러 환산 시총

210만원

최고 목표가 (증권)

2026-04 122만원, 5월 160만원대로 사상 최고를 경신하며 시가총액 1,000조원(약 \$1.0T)을 넘어 세계 16위에 올랐다. 증권가 목표가는 최고 210만원까지 제시됐다.

* 주가·시총 정확치는 시점별 변동. 출처: 서울경제·companiesmarketcap 등.

\$1조 클럽 진입 — 가격은 'AI 사이클 지속'을 베팅한다

세계 16위

글로벌 시총 순위

\$1.0T

시가총액

이익 2배

FY2025 영업이익 증가

삼성·테슬라 등과 어깨를 나란히 하는 시총이지만, 메모리 이익은 사이클에 민감하다. 현재 가격은 HBM 슈퍼사이클이 상당 기간 이어진다는 가정을 선반영한 것으로, 사이클이 꺾이면 멀티플 재평가 위험이 있다.

사상 최대 주주환원 — 배당 확대 + 자사주 매입

3,000원

주당 배당 (FY2025)

2.1조

총 배당 규모

12.2조

자사주 매입

2.1%

매입 비율 (발행주식)

역대 최대 실적을 바탕으로 배당을 주당 3,000원(총 2.1조)으로 늘리고 12.2조 규모 자사주를 매입했다. 이익의 주주 환원 의지를 분명히 한 것이다.

메모리 Big 3 — HBM은 SK 주도, HBM4에서 추격전

SK하이닉스

HBM 1위

HBM3E-HBM4 선점, 엔비디아 다수 공급. 이익률 최고.

삼성전자

종합 1위·HBM 추격

메모리 전체 1위지만 HBM4로 추격 단계.

마이크론

3위·HBM 부상

HBM에서 삼성을 추월했다는 보도(2026).

관전 포인트는 HBM4다 — SK가 선두를 지키느냐, 삼성·마이크론이 따라잡느냐가 향후 점유율을 가른다.

강세 논거 — HBM 선두 + 이익률 + 주주환원

HBM 선두

HBM3E·HBM4 최초 양산, 엔비디아 다수 공급 — AI 메모리 표준 지위.

이례적 수익성

영업이익률 49%(연간)·72%(분기) — 메모리 사상 최고 수준.

실적 모멘텀

분기 영업이익 5분기 만에 5배. 매출 첫 50조 돌파.

주주환원 강화

배당 확대 + 12.2조 자사주 매입 — 이익의 환원 의지.

핵심 리스크 — 사이클·집중·경쟁·밸류에이션

01

메모리 사이클

슈퍼사이클의 반대 국면 위험. 과거 다운사이클 적자 전례.

02

고객·제품 집중

실적이 HBM/AI 가속기(특히 엔비디아) 수요에 크게 의존.

03

경쟁 추격

삼성·마이크론의 HBM4 진입, 중국(CXMT) 범용 추격.

04

밸류에이션

주가 급등(시총 \$1T) 후 이익 둔화 시 조정 위험.

05

대규모 capex

용인·패키징 투자 부담과 회수 시점.

06

지정학·규제

대중 수출규제·환율·공급망 불확실성.

사상 최대 실적의 지속성은 'HBM 우위'와 '사이클'에 달렸다

강세 논거

- ▲ HBM 선두 + 엔비디아 다수 공급 — AI 메모리 표준.
- ▲ 영업이익률 49~72% — 이례적 수익성·현금창출.
- ▲ 주주환원 강화(배당·자사주)로 신뢰 제고.

점검 포인트

- 메모리 사이클 반전 위험 — 이익의 변동성.
- HBM4 경쟁(삼성·마이크론)·고객 집중.
- 시총 \$1T 선반영 — 밸류에이션 부담.

WATCHLIST

HBM4 양산 수율·점유율 · 메모리 가격 · 경쟁사 추격 · 사이클 지속성

2026 — HBM4 ramp와 메모리 강세가 모멘텀을 잇는다

HBM 슈퍼사이클

AI 가속기 수요로 HBM·고부가 메모리 강세 지속, 시장 확대.

HBM4 ramp

업계 최초 양산, 엔비디아 차세대(Rubin)향 다수 공급 목표.

HBM3E 주류

2026 HBM 출하의 약 2/3가 HBM3E, HBM4 점진 확대.

선단 공정 전환

DRAM 1cnm·NAND 321단으로 데이터센터 수요 대응.

투자 포인트 — 'AI 메모리 슈퍼사이클'을 사는 종목

성장

HBM·AI 메모리

AI 가속기 수요가 핵심 동력 — 엔비디아·데이터 센터 의존도 높음.

수익성

이익률 사상 최고

현 가격은 높은 이익률의 지속을 가정 — 사이클 관건.

변동성

사이클 민감

메모리 특성상 호황/불황 진폭 큼. 시간지평·리스크 허용도 점검.

결론: 'AI 메모리 슈퍼사이클'의 대표 수혜주. 단, 메모리 사이클·경쟁·밸류에이션을 함께 보아야 한다.

재무 요약 — 연간·분기

연간 실적 (조원)

구분	매출	영업이익	이익률
FY2024	66.2	23.5	35%
FY2025	97.1	47.2	49%

97.1조

FY2025 매출

47.2조

FY2025 영업이익

분기 영업이익 (조원)

분기	영업이익	비고
2025 Q3	11.4	첫 10조
2025 Q4	19.2	+68% QoQ
2026 Q1	37.6	이익률 72%

37.6조

2026 Q1 영업이익

APPENDIX · BUSINESS

사업·시장 요약

항목	값	비고
DRAM 점유율	30%	글로벌 2위 (2024)
NAND 점유율	20%	(2024)
HBM 점유율	55~62%	1위 (추정)
엔비디아 HBM4	54~70%	전망 (추정)
임직원	46,863	2024

1,000조

시가총액 (₩)

세계 16위

글로벌 시총 순위

3,000원

FY2025 주당배당

12.2조

자사주 매입

데이터 검증 상태와 한계를 명시한다

교차확인 (핵심)

FY2025 97.1조/47.2조·분기 영업이익 합치·2026 Q1 37.6조 — 다수 매체 일치.

HBM 점유율 추정

전체 55~62%·엔비디아 HBM4 54~70% — 증권가/리서치 추정, 편차.

주가·시총 변동

160만원대·1,000조·\$1T·세계16위 — 시점별 변동, 기록 시점 기준.

원자료 보정

일부 분기 순이익 원자료 파싱오류분은 폐기 — 영업이익·매출 중심.

경쟁 점유율

SK62/마이크론21/삼성17은 Astute 등 추정 — '추정' 표기.

회사 발표

재무는 SK hynix 공식 실적발표(K-IFRS) 기준.

방법론과 면책

데이터 출처

SK hynix 공식 실적발표·뉴스룸(K-IFRS), CNBC·TrendForce·Korea Times(실적), Seoul Economic Daily·companiesmarketcap(주가·시총), Counterpoint·UBS·Astute(HBM).

교차검증

핵심 수치는 2개 이상 출처 교차. 불일치는 '출처 편차'로 표면화. 추정·회사발표는 별도 표기.

통화·기준

금액은 원(₩) 조 단위, K-IFRS 연결. 기준일 2026-06-15. 주가·시총은 기록 시점 기준.

면책

본 자료는 공개 정보 기반 분석으로 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.

한 장 요약

기록

FY2025 매출 97.1조·영업이익 47.2조(이익률 49%) — 사상 최대, 삼성 상회.

동력

HBM 1위·엔비디아 다수 공급. 2026 Q1 영업이익률 72%로 가속.

가치

시총 1,000조(~\$1T, 세계 16위). 가격은 슈퍼사이클 지속을 선반영.

관점

AI 메모리 대표 수혜주 — 단 사이클·경쟁·밸류에이션이 변수.

SK하이닉스는 'AI 메모리의 현재'를 지배하고 있다 — 관건은 이 슈퍼사이클을 얼마나 오래 끌고 가느냐다.

기준일

2026-06-15 · FY2025 + 2026 Q1

자료

SK hynix 실적발표 · CNBC·TrendForce · 서울경제

면책

공개 정보 기반 분석 · 투자 권유 아님